

非硅导热灌封胶 XK-SN20®

特性：

1:1混合（无副产品）
高接着应用
操作简单方便
加热加速反应



应用：

汽车电子
通讯设施
计算机及周边产品
导热
热源与散热器间应用

	unit	XK-SN20	Method
Resin type		epoxy	
Color		gray	Visual
Viscosity, dynamic at 23°C	mPa.S	50000	
Specific Gravity	g/cm3	2.5	ASTM D792
Hardness	Shore D	90	ASTM D2240
Thermal impedance@0.5mm	°Cin2/W	0.72	ASTM D5470
Thermal Conductivity	W/mK	1.5	HOT DISK
Volume Resistivity	Ωcm	>10 ¹³	ASTM D257
Breakdown Voltage	KV/mm	10	ASTM D149
Dielectric Constant	1	6	ASTM D150
Application temperature	°C	-40~150	
Coefficient of thermal expansion		2.6 X10 ⁻⁵	ASTM D696
Lap shear strength to aluminum	psi	2000	ASTM D1002
Tensile strength	psi	1500	ASTM D412
Glass Transition Temp	°C	120	DSC
Siloxane Volatiles D4~D20	%	0	GC-FID
Flammability	UL94	V-0	UL94

XK-SN20 使用操作程序:

此 XK-SN20 胶属于 EPOXY 2K

1. AB 比例 1:1 , AB 胶两剂要混合均匀
2. 使用工具: 自动点胶机 或 手动供料枪
3. 熟化时间与点胶量(成品厚度)有关

Special features

excellent bond strength to most substrates including metals, wood, engineering thermoplastics, composite matrix and ceramics 适用在多种表面黏着(金属,木,工程塑料,复合材料,陶瓷材料)

low shrinkage and low coefficient of thermal expansion. 低收缩率 低热膨胀

Pot life

25℃	30min~60min	(30~60 分钟)
40℃	10min	(10 分钟)

Processing

Recommended Cure Condition	100℃ 1hour + 150℃ 1hour
Alternate Cure Condition	150℃ 0.5hour

注意要点:

1、接触面:

因此在使用之前请充分搅拌均匀 ,并清洁并干燥接触表面,特别是与新材料接着,请先行做试验

2、保存方法

- 最佳保存方式在未混合使用前,放置冰箱冷冻(-15 度) 可保存 6~12 个月
- 常温保存在未混合使用前,放置干燥常温(25 度) 可保存 1~3 个月
- AB 剂混合后需一次用完,无法留至日后继续使用